HPERC-IBR-MC

高性能军用宽温级系统，支持 Intel® Core™ i7 处理器和冷却板散热

特点

- 符合SWaP的高密闭小规格计算平台
- 符合VITA 75标准的安装方式，采用导冷散热
- 支持Intel® Core™ i7双核或四核处理器
- DDR3L-1333 8GB板贴内存，最高支持16GB
- 四个千兆以太网口
- 超快速的固态RAID
- 通过16通道第三代PCI Express总线，可以支持GPGPU
- 简单的用户扩展和配置
- 支持军用宽温规格：-40°C 至 +85°C

规格

核心系统

CPU	Intel® Core™ i7-3517UE 1.7GHz, 双核
	Intel® Core™ i7-3555LE 2.5GHz, 双核
	Intel® Core™ i7-3612QE 2.1GHz, 四核
芯片组	Intel® QM77 Express芯片组
GP-GPU	通过MXM可使用Nvidia显卡或AMD
内存	16GB DDR3L-1333 ECC
	8GB板贴，8GB SODIMM
BIOS	AMI® EFI
扩展总线	MXM(第三代PCIe x16)
	PCI/104 Express® Type 2(第二代PCIe)
	PCI Express 迷你卡(第二代PCIe)

标准I/O

视频	1x VGA
音频	1x 放大的立体声输出
	1x 单声道麦克风输入
LAN芯片组	4x Intel® I210以太网控制器
LAN速度	10/100/1000Mbps
USB	6x USB 2.0
串口	7x RS-232/422
GPIO	8x 数字IO

内部存储

可拆卸SATA	2x 2.5" SLC固态硬盘，SATA 6Gb/s(最高支持1TB)
RAID	支持RAID 0/1，最高速度可达12Gb/s
可拆卸	1x SDHC - SLC(最高支持64GB)

安全

TPM	Atmel AT97SC3204-U1A190
安全擦除	软件触发

电源

输入	9-36V DC
性能	P-状态 0-16 (Speedstep & Turbo)
	S-状态 S3, S4, 和IFFS

散热

内部转移	被动散热传导至外壳
存储温度	-55°C 至 +85°C
工作温度	军用宽温：-40°C 至 +85°C
	导冷散热
	符合VITA-75.22安装标准

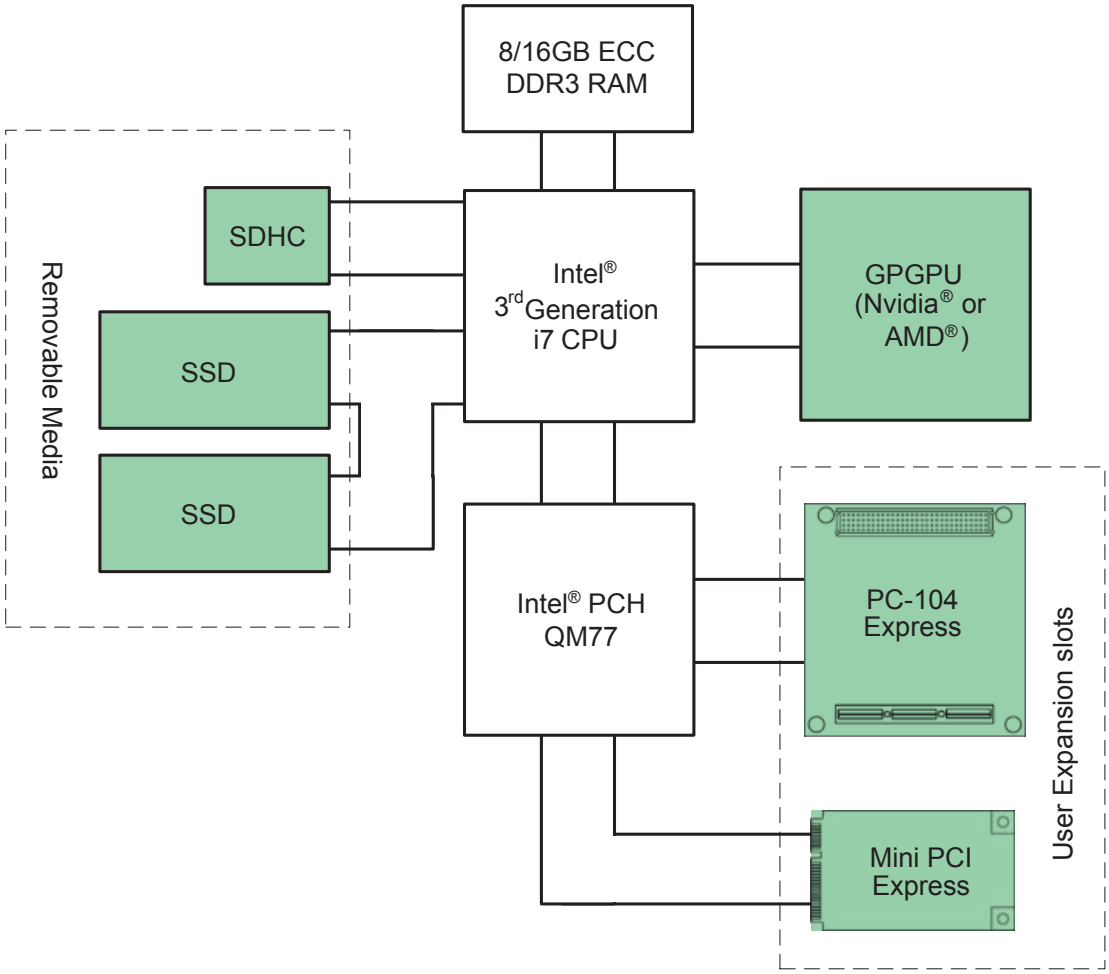
环境参数

浸泡	IEC 529 - IP-67
	MIL-STD-810G - 512.5 流程 I
湿度	95% @ 60°C，无凝露
冲击	MIL-STD-810G - 516.6 流程 I 和 V
振动	MIL-STD-810G - 514.6 流程 I
	类别4, 7-9, 13-15
EMI/EMC	MIL-STD-461F
	FCC EN55022 ClassB
温度	MIL-STD-810G - 501.5, 流程 II, 方法 1 和 3
	MIL-STD-810G - 502.5, 流程1和 2

机械结构

规格	VITA-75.22导冷板
尺寸	63.5 x 150 x 203.4mm
重量	3.12kg
IO连接器	MIL-DTL-38999(唯一标识)

功能示意图



订购指南

配件

型号	描述/配置
HPERC™附件	
HPERC™-X-01	HPERC™ 分支电缆套件，包括所有IO和AC适配器
CC-DDR3－HPERC™	可选的适用于HPERC™ 16GB内存的三防喷涂
CC-HPERC™-IBR	可选的适用于HPERC™-IBR的三防喷涂

配置

型号	描述/配置
HPERC-IBR-MC	
HPERC-IBRMC-102NS7	D38999接口, 导冷散热, 第三代双核2.8 GHz 17W i7 (3517UE), 2x128GB SLC noRAID, 16GB RAM, Windows®Standard 7 (64位)
HPERC-IBRMC-B02NS7	D38999接口, 导冷散热, 第三代双核2.8 GHz 17W i7 (3517UE), 2x128GB SLC noRAID, 8GB RAM,Windows®Standard 7 (64位)
HPERC-IBRMC-101NS7	D38999接口, 导冷散热, 第三代双核2.8 GHz 17W i7 (3517UE), 2x64GB SLC noRAID, 16GB RAM, Windows®Standard 7 (64位)
HPERC-IBRMC-B01NS7	D38999接口, 导冷散热, 第三代双核2.8 GHz 17W i7 (3517UE), 2x64GB SLC noRAID, 8GB RAM, Windows®Standard 7 (64位)